

2011年3月期 通期決算概要

ルネサス エレクトロニクス株式会社

2011年5月18日

代表取締役社長 赤尾 泰

(本プレゼンテーションに関する注意)

本資料における前連結会計年度(2010年3月期)の業績数値は、旧NECエレクトロニクス(株)と旧(株)ルネサス テクノロジ(以下、旧両社)の前連結会計年度の業績数値を単純合算したものであります。なお、「売上高」および「半導体売上高」については、旧NECエレクトロニクス(株)の表示方法と整合させるために旧(株)ルネサス テクノロジについて一部組替表示しております。

(将来予測に関する注意)

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略および業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、(1)ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。

エグゼクティブ・サマリー

I. 2011年3月期 通期 決算概要

- 震災影響等により売上高は前回想定を下回ったものの、構造対策の着実な実行や統合シナジー効果などにより、通期営業黒字を達成
- 構造対策の実行に加え、東日本大震災の影響などにより1,182億円の特別損失を計上

II. 東日本大震災の影響と復旧に向けて

- 那珂工場の早期復旧や代替生産等により製品供給の最大化を実現
- 震災の影響をふまえた投資の抑制、費用の削減等の実行

I. 2011年3月期 通期 決算概要

2011年3月期 決算概要

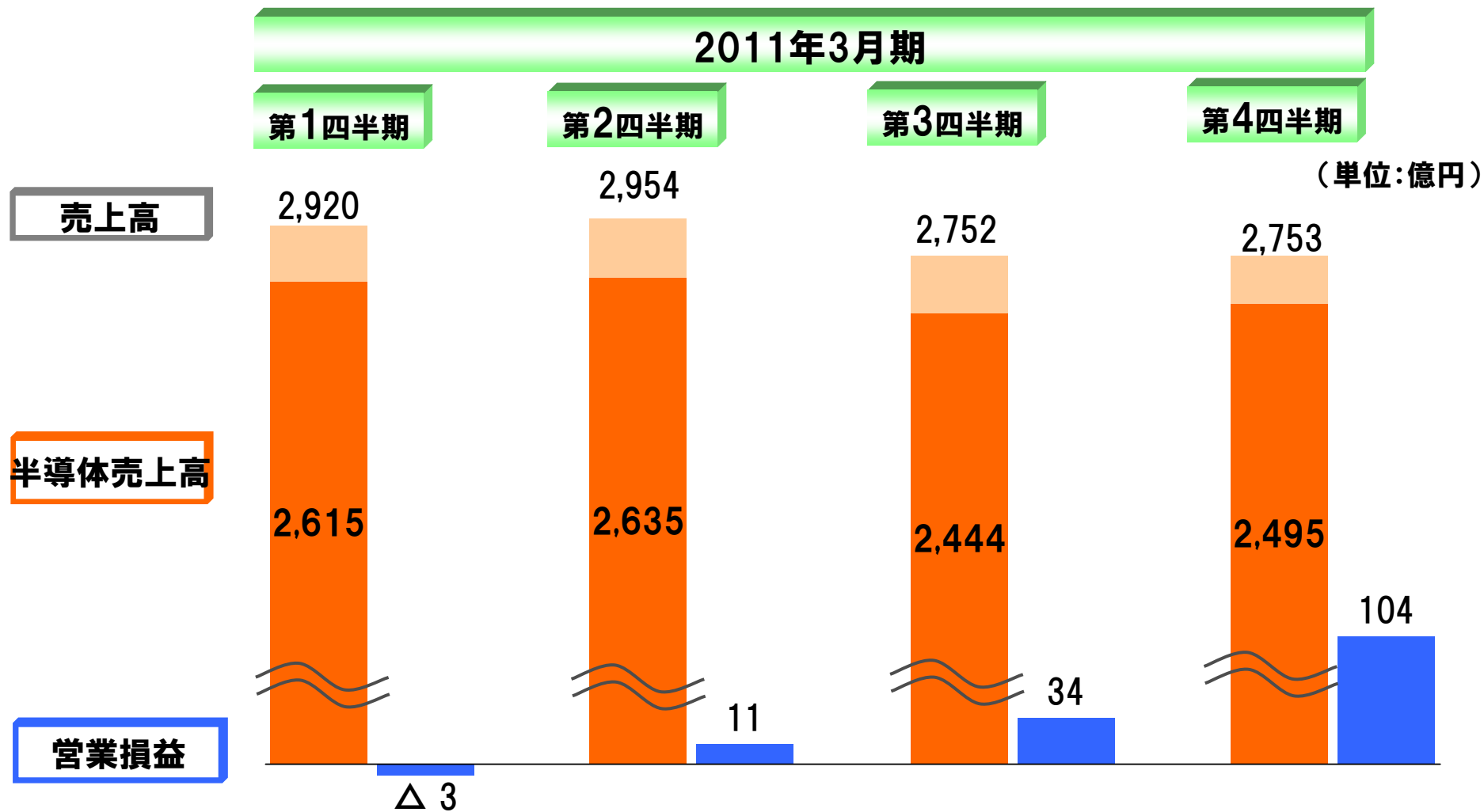
- 統合初年度の経営目標であった通期営業黒字を達成
- 構造対策の実行に加え、東日本大震災の影響による特別損失を計上

(単位:億円)	2011年3月期					
	第4四半期	前四半期比		通期	前回予想比	前期比
売上高	2,753	+1		11,379	△121	+755
半導体売上高	2,495	+50		10,189	△111	+764
営業損益	104	+70		145	+75	+1,278
経常損益	78	+67		10	+60	+1,264
当期純損益	△562	△386		△1,150	△350	+228
1US\$=	83円	±0円		86円	-	-
1ユーロ=	111円	1円高		114円	-	-

注)前期比は、旧両社の合算値もしくは一部組み替え後の数値からの比較を記載

2011年3月期 四半期決算概要

■ 営業損益は四半期毎に改善傾向



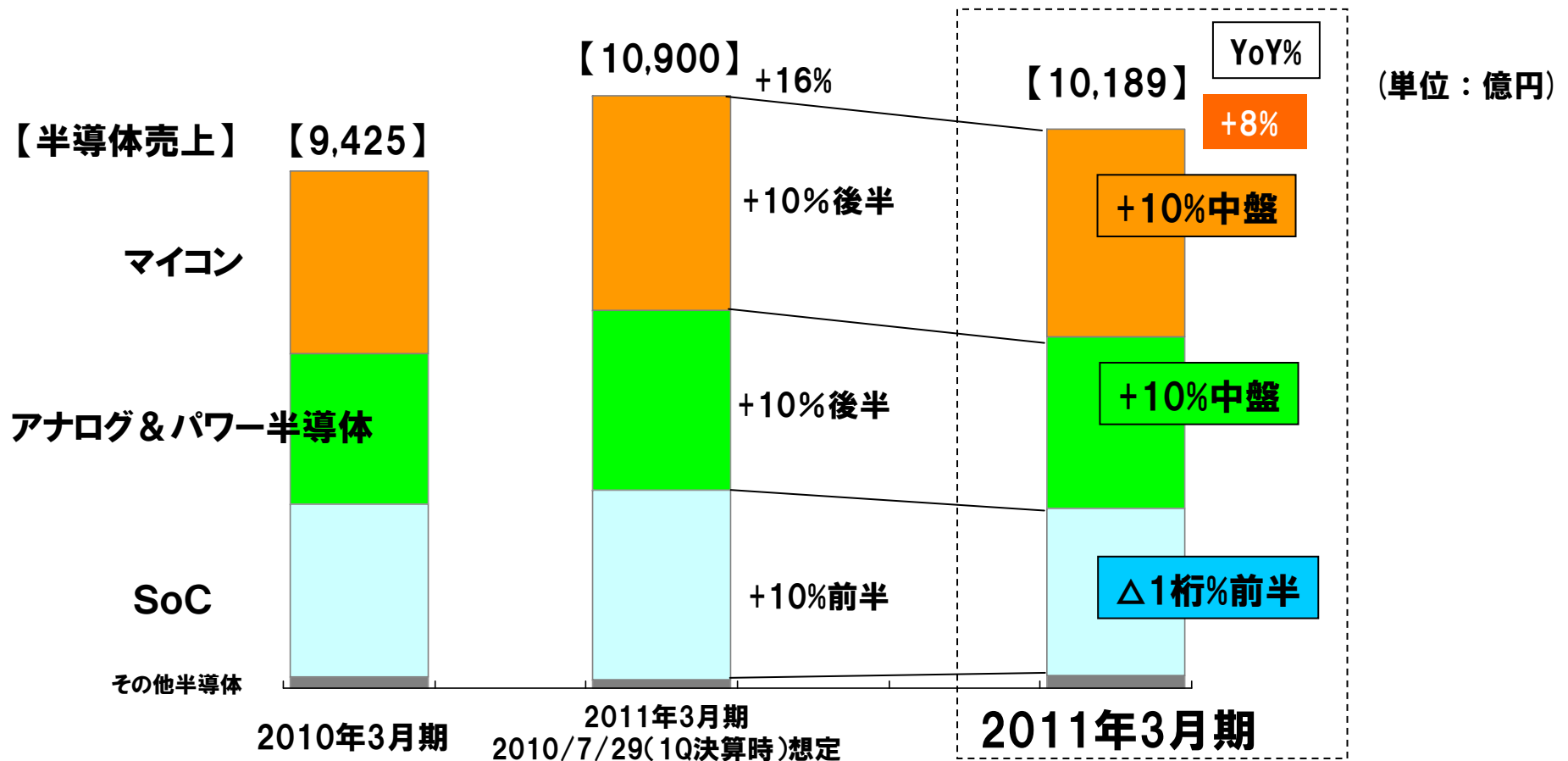
2011年3月期 半導体売上高の事業別状況

- マイコンとアナログ&パワー半導体事業は、前期(2010年3月期)比で半導体売上高全体の伸びを上回る増収を達成

(単位:億円)	2011年3月期		
	第4四半期	前四半期比 (%)	通期
半導体売上高 計	2,495	+2%	10,189
マイコン	950	+1%	3,841
アナログ&パワー 半導体(A&P)	770	+6%	3,162
SoC	747	△2%	3,117
その他半導体	27		69

2011年3月期 半導体売上高の事業別状況

- 海外市場は中国を始めとする新興国での需要が自動車やスマートフォン向けカメラLSI、表示ドライバ向けに堅調
- 国内市場は上期後半以降、自動車・民生分野の需要減に加え、国内フィーチャーフォン向け通信LSIが不振
- 円高の進行(1ドル想定90円が86円)により約160億円の減収要因

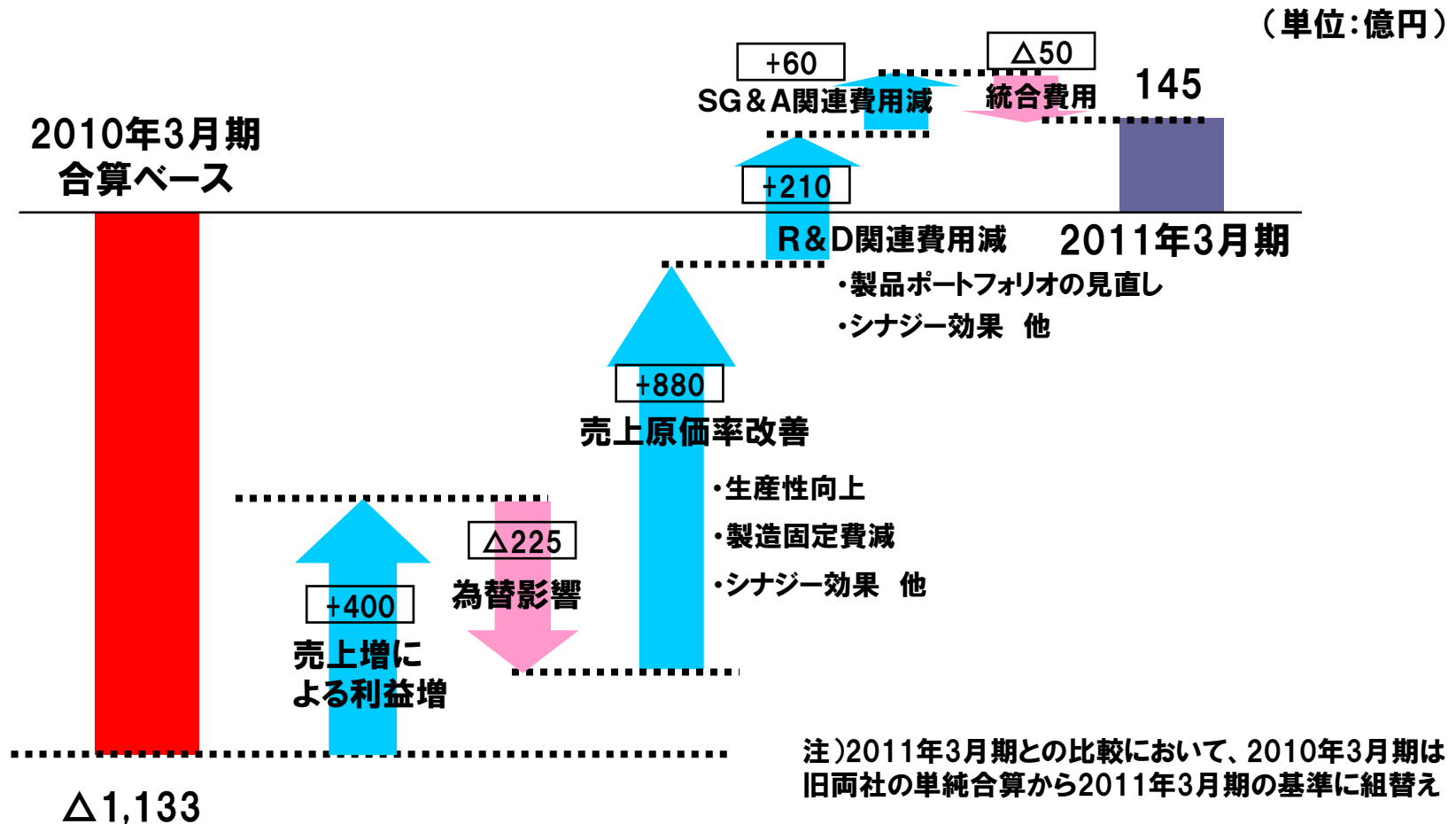


2011年3月期 半導体売上高の事業別状況

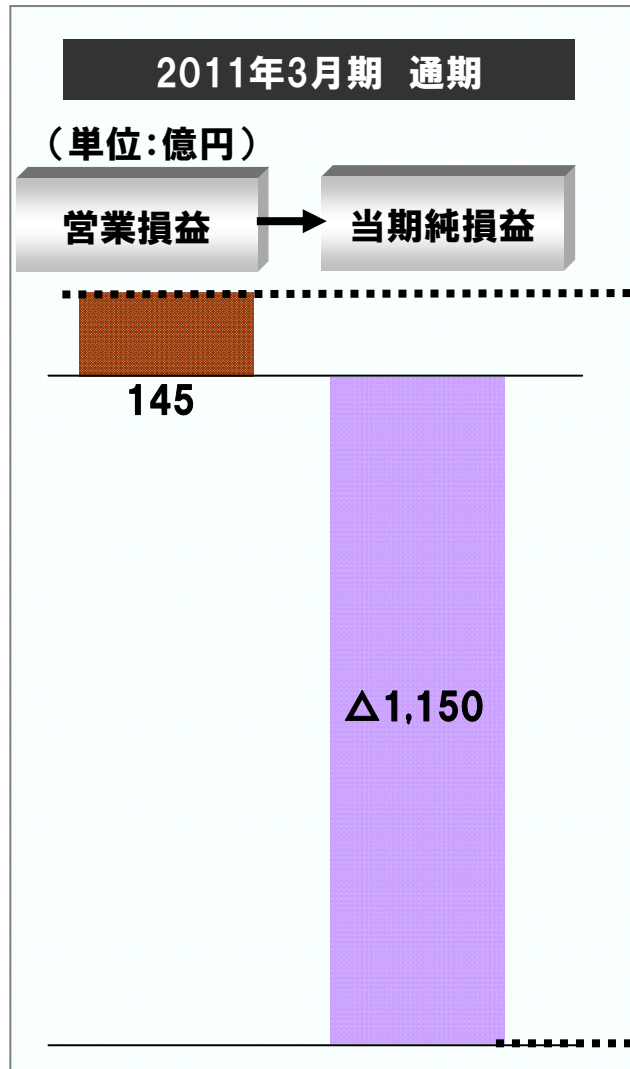
	分野対前期増減	対前期増減主要因
<p>自動車 約45%</p> <p>マイコン 通期売上高</p> <p>汎用 約55%</p>	<p>自動車分野 ↑</p> <p>汎用分野 ↑</p>	<p>➢ 統合後も自動車分野向けW/W高シェアを堅持</p> <p>➢ 中国をはじめとする新興国の産業・民生機器市場好調。売上大幅増</p>
<p>化合物半導体 約15%</p> <p>パワー半導体 & アナログIC 約65%</p> <p>表示ドライバIC 約20%</p> <p>半導体通期売上高</p>	<p>パワー半導体 & アナログIC ↑</p> <p>表示ドライバIC ↓</p>	<p>➢ 新興国における自動車市場の拡大及び電装化率増によりパワー半導体 & アナログIC売上増</p> <p>➢ 表示ドライバICはスマートフォン市場の拡大により小型パネル向けは売上増、大型パネル向けは苦戦</p>
<p>自動車 約10%</p> <p>モバイル分野 約35%</p> <p>産業分野 約10%</p> <p>PC周辺 約15%</p> <p>民生機器 約30%</p> <p>SoC 通期売上高</p>	<p>モバイル分野 ↓</p> <p>民生分野 ↓</p> <p>PC周辺分野 ↓</p> <p>産業分野 ↑</p> <p>自動車分野 ↑</p>	<p>➢ モバイル分野はスマートフォン向けカメラLSI売上増も、国内フィーチャーフォン市場伸び悩みで、通信LSI売上大幅減</p> <p>➢ PC周辺(HDD、光ディスク向け)向け市場減速により売上減</p>

2011年3月期 通期営業損益の増減分析(対前期比)

- 売上増に加えて、生産性の向上に伴う売上原価率の改善や、設備投資の抑制等による減価償却費の削減、製品ポートフォリオの見直し等による研究開発費の抑制などにより、通期営業黒字を達成



2011年3月期 当期純損益の状況



- 構造対策の実行により約670億円の特別損失を計上
- 東日本大震災の影響により495億円の特別損失を計上

営業外損益
△135億円

特別損益 (特別利益63億円、特別損失1,182億円)
△1,118億円

<構造対策(100日pj)>

- ・事業・生産構造対策 約450億円
- ・人的効率化施策 約220億円

特別損失
の主な内訳

<東日本大震災の影響>

- ・災害による損失 495億円
(保険による一部損失補填含む)

法人税等、少数株主損益
△42億円

100日プロジェクト進捗状況 ①成長戦略

～事業ポートフォリオの最適化～

	主な施策
マイコン事業	<ul style="list-style-type: none">・プロセス・CPUコア・周辺IPなどを片寄せ・統合・新興国、特に中国の需要を取り込むべく、中国の販売子会社に現地社員をトップとする事業推進組織を新設・中国向けに1,000製品を開発(2012年までに)
アナログ&パワー半導体事業	<ul style="list-style-type: none">・両事業のマーケティング機能を一体化し、市場、特に海外に対する直接的な働きかけを強化・自動車及び電源分野を中心とした製品ラインアップ・キットソリューションを拡充・低耐圧から高耐圧までのパワー製品ラインアップの強化(3年間で1,000製品投入)
SoC事業	<ul style="list-style-type: none">・グローバル市場で大きな拡大が見込まれるLTEモデムプラットフォーム事業を推進するため、NOKIA社からLTEモデム技術を導入しルネサスモバイルを設立・産業/通信等の社会インフラを注力分野と定め、リソースを集中

100日プロジェクト進捗状況 ②統合シナジー実現

	主な施策
販売	<ul style="list-style-type: none"> ・国内特約店商流の絞込みと強化【30⇒16社、10年度3Q完】 ・国内外販売拠点の統合【38⇒16拠点、10年度3Q完】
設計・開発	<ul style="list-style-type: none"> ・マルチメディアSoCの共通プラットフォームを導入【10年度3Qに第1弾製品(R-Car)を発表】 ・ローエンドマイコンのCPUコアを統合(5⇒4CPUコア)【10年度4Qに新コア第1弾製品(RL78)のサンプル出荷開始】 ・旧両社製品・技術の徹底したベンチマークにより製品・技術ロードマップを統合【28nm以降の先端プロセスのR&Dを一本化】 ・開発環境を統合し設計費用削減
生産	<ul style="list-style-type: none"> ・ファブネットワーク構築、ファウンドリ・サブコンの活用、生産固定費の機動的な抑制等による変動対応力の強化 ・チップサイズ縮小、PKG小型化、テスト時間短縮
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・物流、倉庫、情報システムなどの統合

100日プロジェクト進捗状況 ③構造対策実行

- 想定を下回る損失・費用となった施策があったことなどにより、特別損失の計上額が想定比で約100億円減少しているが、構造対策の進捗はほぼ予定どおり

	主な施策
事業・生産構造対策 約450億円 (前回想定:約530億円)	<ul style="list-style-type: none"> ・鶴岡、ローズビル工場の減損 ・ローズビル工場の売却 ・滋賀(5インチ閉鎖予定)、福岡(閉鎖予定)、高知(一部貸与)など生産ラインの再編
人的効率化対策 約220億円 (前回想定:約240億円)	<ul style="list-style-type: none"> ・早期退職優遇制度の実施(3/31付 計1,487名) ・販売特約店や大株主3社などへの転出(約700名) ・生産構造対策に伴う人的効率化(ローズビル売却 約600名など) ・注力分野への社内シフト(約1,000人規模)
計 約670億円 (前回想定:約770億円)	

バランスシートの状況

(単位:億円)	10/4期首 (増資後)	10/12末	11/3末
総資産	12,154	11,513	11,450
うち 現金および現金同等物	3,377	3,343	3,373
うち たな卸資産	1,266	1,440	1,234
負債合計	8,017	8,084	8,540
うち 有利子負債	3,720	3,667	3,782
株主資本	4,210	3,622	3,060
純資産合計	4,136	3,429	2,911
D/Eレシオ(グロス)	0.91倍	1.09倍	1.33倍
D/Eレシオ(ネット)	0.08倍	0.09倍	0.12倍
自己資本比率	33.5%	29.2%	24.8%

- (注1)①現金および現金同等物:「現金および預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3か月を超える定期預金」を控除しております。
 ②有利子負債:「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「リース債務」、「新株予約権付社債」、「長期借入金」
 ③自己資本:「株主資本」、「その他の包括利益累計額」
 ④D/Eレシオ(グロス):有利子負債/自己資本
 ⑤10/4期首(増資後)の負債合計には、負ののれん22億円を便宜的に含めております。
- (注2)「10/4期首(増資後)」の数値は、当連結会計年度期首の数値に2010年4月1日付の企業結合に係る会計処理および同日付の第三者割当増資約1,346億円を反映した数値です。

キャッシュ・フローの状況

■ 設備投資の抑制などにより、通期のフリー・キャッシュ・フローは黒字を確保

(単位：億円)	2011年3月期				
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	通期
営業活動による キャッシュ・フロー	△20	350	539	156	1,025
投資活動による キャッシュ・フロー	△144	△184	△390	△240	△958
フリー・ キャッシュ・フロー	△164	166	150	△84	67

II. 東日本大震災の影響と復旧に向けて

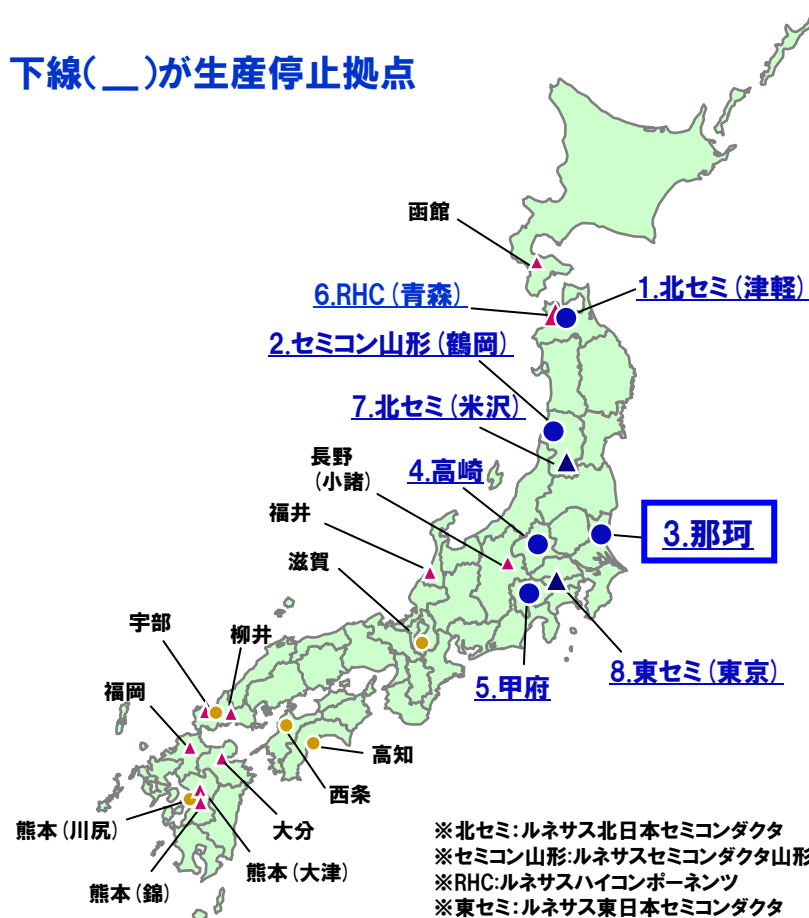
震災により生産停止した拠点と復旧状況

- 那珂工場を除き、生産停止した拠点は全て生産再開
- 那珂工場についても、6月から一部限定能力にて生産再開 (ウエハ投入) 予定

＜生産停止した拠点と復旧状況＞

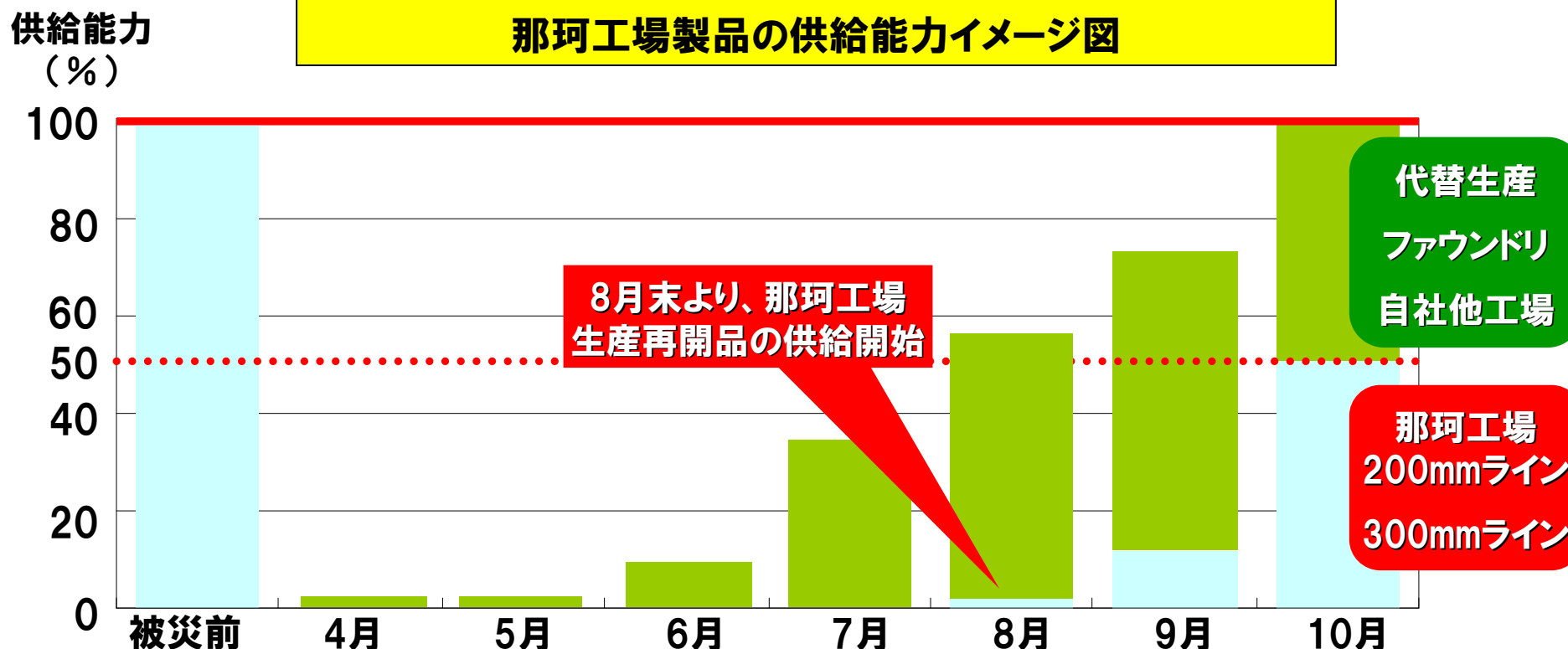
	拠点	稼働状況	主な生産品目
前工程	1. 北セミ (津軽)	生産再開	車載用マイコン
	2. セミコン山形 (鶴岡)	生産再開	汎用IC SoC
	3. 那珂	停止中 6月一部 生産再開予定	車載マイコン、汎用マイコン 汎用IC SoC
	4. 高崎	生産再開	パワーデバイス、アナログIC
	5. 甲府	生産再開	パワーデバイス、アナログIC
後工程	6. RHC (青森)	生産再開	汎用IC
	7. 北セミ (米沢)	生産再開	車載マイコン、汎用マイコン
	8. 東セミ (東京)	生産再開	RF ICs

下線()が生産停止拠点



那珂工場の復旧、代替生産計画

- 被災前に那珂工場で生産していた製品について、まずはお客様への製品供給の充足(供給能力100%)を最優先に、那珂工場を復旧
- 10月末には、那珂工場生産再開分と代替生産(ファウンドリ+自社他工場)を合わせて、供給能力100%に回復)



注:お客様への製品供給は代替生産分、那珂工場生産再開品分以外に震災前の完成品在庫、生産途上品からの完成品によっても行っています。

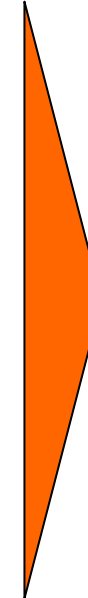
10月末に、那珂工場生産再開分と代替生産分で供給能力完全復旧

ファブネットワークの推進を加速

- 今回の震災を教訓に、需要変動や突発的な事象に対するさらなる変動力強化として、統合後行ってきたファブネットワークを一層推進
- ファブネットワークを前提とした製品開発の促進により、ファブネットワークを強化

<那珂工場におけるファブネットワーク例>

那珂工場	主要代替先	
	自社他工場	ファウンドリ
200mmライン	<ul style="list-style-type: none"> ・ルネサス北日本セミコンダクタ 津軽工場 ・西条工場 	<ul style="list-style-type: none"> ・グローバルファウンドリーズ
300mmライン	<ul style="list-style-type: none"> ・ルネサス山形セミコンダクタ鶴岡工場 ・西条工場 	<ul style="list-style-type: none"> ・TSMC



被災前の那珂工場
生産製品の約半分を
代替生産

東日本大震災による影響

- 震災による損失見積額は655億円。保険による損失補填見込額160億円を差し引き、2011年3月期に震災による特別損失を495億円計上

<内訳>	<金額>
固定資産の修繕費(原状回復費用)	431億円
たな卸資産廃棄損	73億円
固定資産の廃棄損	62億円
操業休止の固定費(不稼働損失)	59億円
リース解約損失、その他	30億円
震災による損失 計	655億円
未収受取保険金	△160億円
震災による特別損失 計	495億円

うち、那珂工場
における損失が
全体の約85%

東日本大震災による影響

- 今後の業績への影響を最小限にとどめるべく、全力を挙げてあらゆる施策を実行

業績への影響

□ 売上(生産)面

- ✓ 生産ラインの稼働停止による影響
- ✓ 原材料・部品の調達による影響
- ✓ 震災影響による市場の不透明感

□ 利益面

- ✓ 売上(生産)減による利益減
- ✓ 復興関連費用の発生
- ✓ 不稼働損失

対応策

<短期的施策>

- ・売上減の影響最小化
(那珂工場早期復旧、代替生産)
- ・設備投資の抑制
- ・研究開発費の効率化
- ・あらゆる費用(経費)の削減
- ・必要資金の確保

<中期的施策>

- ・事業構造対策の更なる推進
- ・BCP(事業継続計画)の総点検

2012年3月期 業績見通しについて

2012年3月期 業績見通しについて

- 東日本大震災の発生により、当社グループの複数の生産拠点が被災したことに加え、震災の影響により当社グループを取り巻く市場環境の先行きが不透明な状況にあります。
- よって、現時点において合理的な業績予想の策定が困難な状況であることから、2012年3月期の連結業績予想値は開示しておりません。業績予想値につきましては、2011年7月を目処に公表する予定です。
- また、統合初年度の事業運営や東日本大震災の影響などをふまえた当社グループの今後の事業方針に関する説明会を、2011年7月初旬に開催する予定です。

まとめ

まとめ

- 2011年3月期 通期における営業黒字を達成。
- 100日プロジェクトで策定した構造対策プランは予定通り進捗。
- 東日本大震災による業績への影響を最小限にとどめるべく、全力を挙げてあらゆる施策を実行。

RENESAS

ルネサス エレクトロニクス株式会社

© 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.